

기술사 제135회 시험시간: 100분

 분
 자료
 종목
 표면처리기술사
 수험
 성명

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

- 1. 철강의 산처리 공정 중 표면에 발생한 스머트(Smut) 제거 방법을 쓰시오.
- 2. 헐셀시험(Hull Cell Test) 석출 상태를 관찰함으로써 알 수 있는 항목 4가지를 쓰시오.
- 3. 습식도금에서 피도금체를 음극에 장입하는 방식 2가지를 설명하시오.
- 4. pH(Potential of Hydrogen)란 수소이온농도 [H⁺]의 역대수로 정의한다. pH1과 pH3의 수소이온농도는 몇 배 차이가 나는지 설명하시오.
- 5. 페러데이(Faraday)의 법칙에서 전해질 수용액 중에 흐르는 전기량이 일정하면 전극에 석출되는 물질의 양은 무엇에 비례하는지 설명하시오.
- 6. 도금 제품의 내식성 시험 중 가스부식시험에 대하여 설명하고 가스부식시험의 종류를 5가지 쓰시오.
- 7. 건식박막 진공증착 공정의 일종으로 기판(Substrate)원자의 결정학적 배열이 일정한 연관성을 갖도록 박막의 원자를 성장시키는 증착 방법을 설명하시오.
- 8. 전해질 수용액 반응식 aA+bB→cC+dD에서 평형상수[K] 값을 설명하시오.
- 9. 플라스마(Plasma) 표면개질은 물질 표면 성질들에 의해 매우 영향을 받는다. 그 요소 4가지를 쓰시오.



기술사 제135회 시험시간: 100분

	<u> </u>				, , ,	<u>. – </u>	
분	재료	조모	포며처리기수사	수험		성	
야	小五	등학 표현시니기술시	_ 프린시니키(1년시 	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

- 10. 인쇄회로기판(Printed Circuit Board)의 측면부식(Side Etching)이 되었을 때 부식된 깊이의 비율이 1.3보다 커야 하고 통상적으로 2.5~3.6의 값을 보인다. 이것의 명칭을 쓰시오.
- 11. 알루미늄 합금의 표면처리 방법 중 산화피막을 형성하는 공정과정은 탈지 → 에칭 → 연마 → 스머트제거 → (a) → (b) → 봉공처리 → 건조이다. 괄호 (a), (b)의 작업공정 명칭을 쓰고 설명하시오.
- 12. 수소취성은 전기도금 과정에서 발생된 수소가 철강재에 침투하여 모재의 취성을 증가시키는 현상이다. 수소취성을 완화하기 위한 후처리 공정을 설명하시오.
- 13. 이온 플레이팅의 기본 조건 4가지를 쓰시오.



기술사 제135회 시험시간: 100분

		- 1 1200 1				, p	<u> </u>	100 6
Ţ,	분	ᆌㄹ	조모	포며처리기수사	수험		성	
(٥ţ	재료	ठन		번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 건식박막 증착공정인 반응성 스퍼터링(Reactive Sputtering)법에 대하여 설명하시오.
- 2. 스테인리스강의 예민화에 대하여 설명하시오.
- 3. 이온 빔(Ion Beam)으로 세척하는 방법에 대하여 설명하시오.
- 4. 가공 변질층(Deformed Layer)에 대하여 그림과 함께 설명하시오.
- 5. 화성피막처리인 인산염피막처리(Parkerizing)와 흑색산화피막처리(Black Oxidizing)를 비교하여 설명하시오.
- 6. 전기도금에서 양극과 음극의 전류효율(Current Efficiency)에 대하여 설명하시오.



기술사 제135회 시험시간: 100분

	_ , ,,,				, p		
분	재료	조모	표명처리기숙사	수험		성	
야	개묘	9 7	중국 표면서다기술사	번호		명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 알루미늄의 양극산화(Anodizing) 공정에서 봉공처리의 목적과 방법을 설명하시오.
- 2. 진공박막 증착법인 ALD(Atomic Layer Deposition) 증착법에 대하여 설명하시오.
- 3. 스테인리스 재료의 화학연마(Chemical Polishing)와 전해연마(Electro Polishing)를 비교하여 설명하시오.
- 4. 친환경적인 표면처리 방법을 설명하시오.
- 5. 전해전위(電解電位)는 평형전위(平衡電位)보다 항상 크며 분극(分極) 편차의 크기를 과전압(過電壓)이라고 한다. 금속이온의 확산에 의한 활성화과전압(活性化過電壓)에 대하여 설명하시오.
- 6. 광택니켈도금을 위한 1차 광택제와 2차 광택제의 상호 평활작용에 대하여 설명하시오.



기술사 제135회 시험시간: 100분

 분
 재료
 종목
 표면처리기술사
 수험
 성명

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 1. 강의 침탄경화법(Carburizing)에 대하여 설명하시오.
- 2. CVS(Cyclic Voltammetry Stripping)의 전기화학적 원리와 응용기술에 대하여 설명하시오.
- 3. 박막의 면저항(Sheet Resistance)과 비저항의 관계식을 쓰고, 면저항 측정법인 4탐침 측정법(Four Point Probe)에 대하여 설명하시오.
- 4. 피도금체의 활성화처리에 대하여 설명하시오.
- 5. 도금액의 유기 불순물과 무기 불순물의 유입경로, 도금에 미치는 현상, 불순물을 제거하는 방법을 설명하시오.
- 6. 용융아연 도금 공정에서 플럭스(Flux)의 처리 목적을 쓰고, 플럭스(Flux)로 구비해야 할 조건을 5가지 쓰시오.